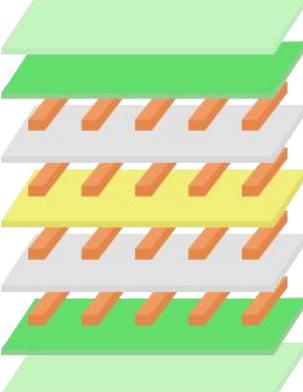


目次

- 一、4層基板..... P1~P3
- 二、6層基板..... P4~P5
- 三、8層基板..... P6~P8
- 四、10層基板..... P9~P10

4層基板						
板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
0.4mm ±0.1mm	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用シルク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	3.8
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8
			L4パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用シルク	0.01mm				
0.6mm ±0.1mm	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用シルク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm/0.08mm	4.2/3.8
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm/0.23mm	4.2/3.8
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm/0.08mm	4.2/3.8
			L4パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用シルク	0.01mm				
0.8mm ±0.1mm	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.33mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
1.0mm ±0.1mm	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.53mm	4.5
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L4パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				
1.2mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.73mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				
1.6mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	1.13mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				
2.0mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	1.53mm	4.5
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L4パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
2.4mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	1.93mm	4.5
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L4パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

ご説明：上記はPCBGOGOの4層基板の参考層構成です。最新の板材と技術に基づいて予告なく変更することがあります。予めご了承ください。層構成をご指定になる場合は、各PCBGOGO営業担当またはservice@pcbgogo.jpにご連絡ください。

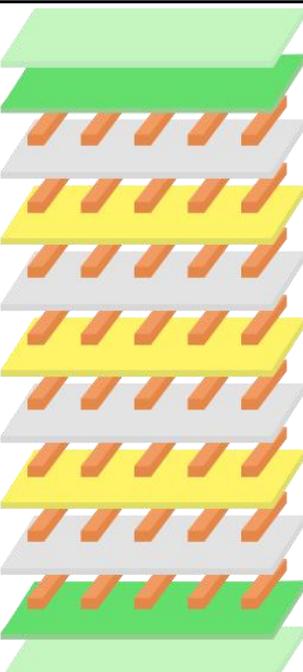
6層基板						
板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
0.8mm ±0.1mm	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	4.2
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L6パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				
1.0mm ±0.1mm	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	4.5
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	4.5
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L6パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				
1.2mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.33mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.33mm	4.2
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L6パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

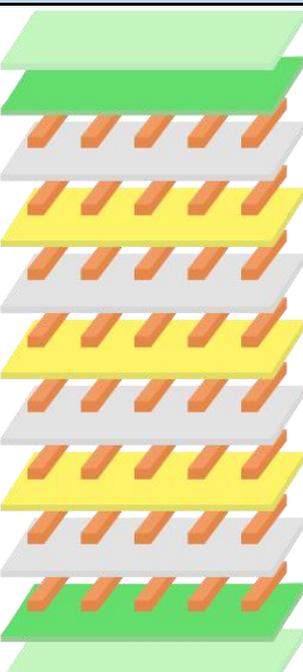
板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
1.6mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.53mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.53mm	4.2
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L6パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
2.0mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.73mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.73mm	4.2
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L6パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

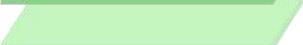
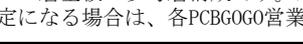
板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
2.4mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.93mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.93mm	4.2
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L6パターン	銅	0.035mm	
			BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

ご説明：上記はPCBGOGOの6層基板の参考層構成です。最新の板材と技術に基づいて予告なく変更することがあります。予めご了承ください。層構成をご指定になる場合は、各PCBGOGO営業担当或いはservice@pcbgogo.jpにご連絡ください。

8層基板						
板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
1.0mm ±0.1mm	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
		TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5	
		L1パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8	
		L2パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	3.8	
		L3パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8	
		L4パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	3.8	
		L5パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8	
		L6パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	3.8	
		L7パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8	
L8パターン	銅	0.035mm				
BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5			
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
1.2mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
		TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5	
		L1パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2	
		L2パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	4.2	
		L3パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2	
		L4パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	4.2	
		L5パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2	
		L6パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	4.2	
		L7パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2	
L8パターン	銅	0.035mm				
BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5			
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
1.6mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm/0.11mm	4.5/4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm/0.23mm	4.5/4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm/0.11mm	4.5/4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm/0.23mm	4.5/4.2
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm/0.11mm	4.5/4.2
			L6パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm/0.23mm	4.5/4.2
			L7パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm/0.11mm	4.5/4.2
			L8パターン	銅	0.035mm	
BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5			
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				
板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
2.0mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.33mm	4.5
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.33mm	4.5
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L6パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.33mm	4.5
			L7パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5
			L8パターン	銅	0.035mm	
BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5			
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
2.4mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.53mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.53mm	4.2
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L6パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.53mm	4.2
			L7パターン	銅	0.035mm	
	プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2		
	L8パターン	銅	0.035mm			
	BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5		
	BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm			

ご説明：上記はPCBGOGOの8層基板の参考層構成です。最新の板材と技術に基づいて予告なく変更することがあります。予めご了承ください。層構成をご指定になる場合は、各PCBGOGO営業担当或いはservice@pcbgogo.jpにご連絡ください。

10層基板						
板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
1.2mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	3.8
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	3.8
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8
			L6パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	3.8
			L7パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8
			L8パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	3.8
			L9パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.08mm	3.8
L10パターン	銅	0.035mm				
BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5			
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				
1.6mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
			TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5
			L1パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L2パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	4.2
			L3パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L4パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	4.2
			L5パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L6パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	4.2
			L7パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
			L8パターン	銅	0.035mm	
			コア材	FR-4	0.13mm	4.2
			L9パターン	銅	0.035mm	
			プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2
L10パターン	銅	0.035mm				
BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5			
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
2.0mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
		TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5	
		L1パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5	
		L2パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	4.5	
		L3パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5	
		L4パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	4.5	
		L5パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5	
		L6パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	4.5	
		L7パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5	
		L8パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.13mm	4.5	
L9パターン	銅	0.035mm				
プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5			
L10パターン	銅	0.035mm				
BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5			
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

板厚	銅箔厚	構造	名称	材質	厚み	誘電率
2.4mm ±10%	10Z (35um)		TOP面シルク	シルク用インク	0.01mm	
		TOP面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5	
		L1パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5	
		L2パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.33mm	4.5	
		L3パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2	
		L4パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.33mm	4.5	
		L5パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2	
		L6パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.33mm	4.5	
		L7パターン	銅	0.035mm		
		プリプレグ	プリプレグ	0.11mm	4.2	
		L8パターン	銅	0.035mm		
		コア材	FR-4	0.33mm	4.5	
L9パターン	銅	0.035mm				
プリプレグ	プリプレグ	0.18mm	4.5			
L10パターン	銅	0.035mm				
BOT面レジスト	レジスト用インク	0.025mm	3.5			
BOT面シルク	シルク用インク	0.01mm				

ご説明：上記はPCBGOGOの10層基板の参考層構成です。最新の板材と技術に基づいて予告なく変更することがあります。予めご了承ください。層構成をご指定になる場合は、各PCBGOGO営業担当或いはservice@pcbogo.jpにご連絡ください。